半导体物理

课后作业09参考解答

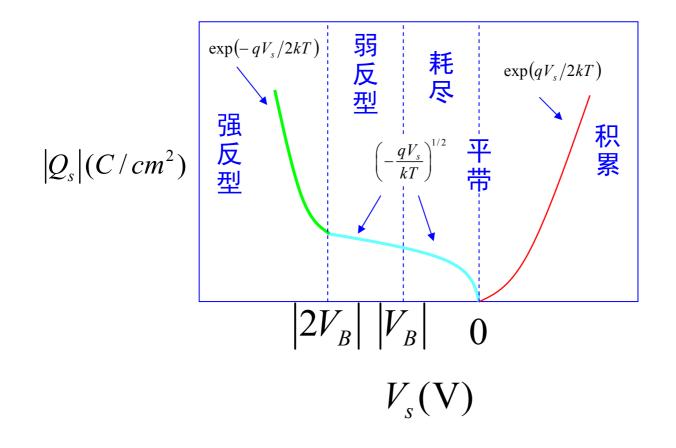
主讲人: 蒋玉龙

微电子学楼312室,65643768

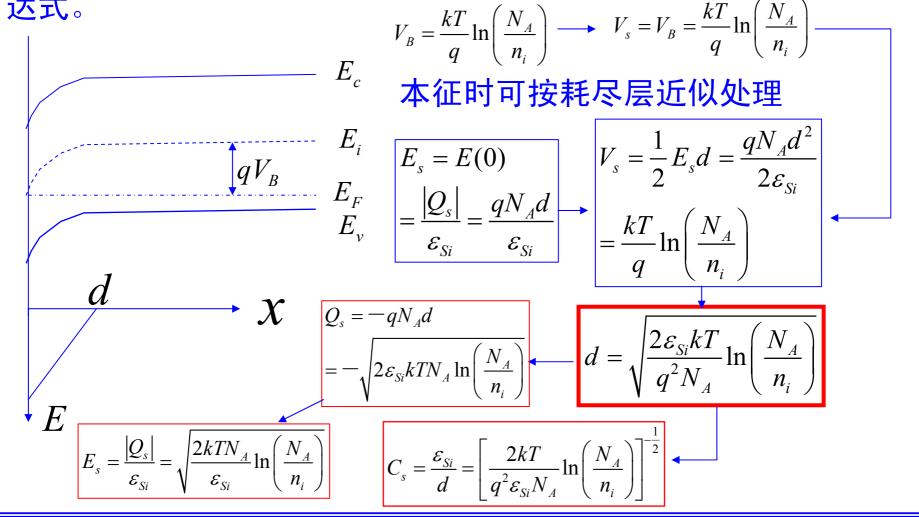
Email: yljiang@fudan.edu.cn

http://10.14.3.121

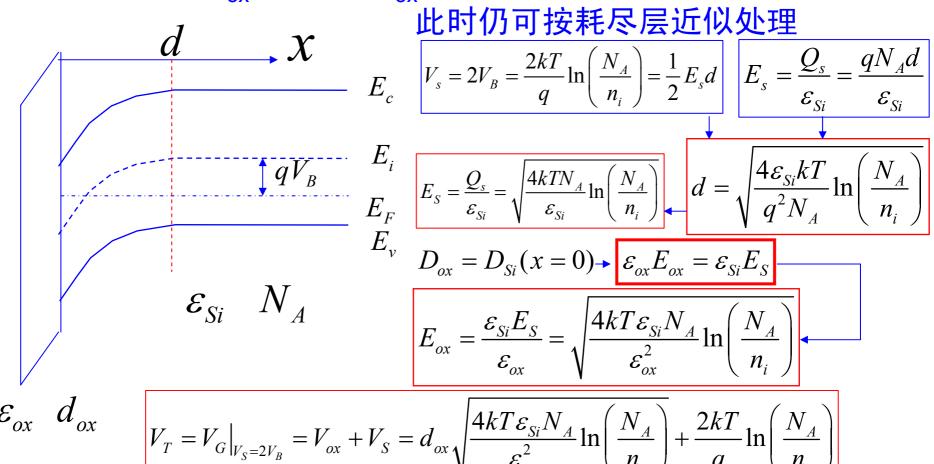
1、画出n型Si的空间电荷层电荷面密度Qs与其表面势Vs的对应关系,并标出空间电荷层各个状态对应的Vs区间。(Qs使用自然对数坐标,参考课本202页的图)



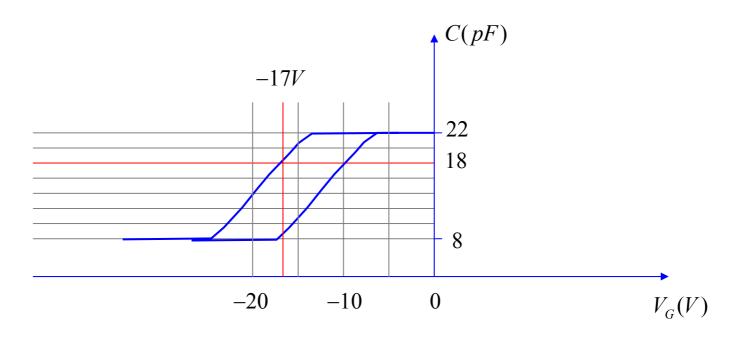
2、用最直观、简单的方法推导出室温下掺杂浓度为 N_A 的p型Si表面恰为本征时的表面电场强度、表面电荷密度和表面层电容的表达式。



3、用最直观、简单的方法导出室温下p-Si衬底对应的理想MIS结构的开启电压表达式。(Si介电常数为 ϵ_{Si} ,掺杂浓度为 N_A ,SiO₂层介电常数为 ϵ_{ox} ,厚度为 d_{ox})



4、用n型Si单晶片做为衬底制备MIS电容。金属电极使用AI,面积为1.6E-7m²,功函数为4.25eV。绝缘层采用SiO₂,相对介电常数3.9。在200°C下做高频正负偏压B-T实验,测量所得C一V曲线如图所示。求该SiO₂中的可动电荷面密度。



1) 高频实验可以给出衬底掺杂浓度N_D

$$C_{ox} = A \frac{\varepsilon_{ox}}{d_{ox}} = 1.6 \times 10^{-3} \times \frac{3.9 \times 8.85 \times 10^{-14}}{d_{ox}} = 22 \times 10^{-12} F$$

$$d_{ox} = 2.5 \times 10^{-5} cm = 0.25 \mu m$$

$$\frac{C'_{\min}}{C_{ox}} = \frac{8}{22} = \frac{1}{1 + \frac{\varepsilon_{ox}}{\varepsilon_s} \left[\frac{4\varepsilon_s kT}{q^2 N_D} \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) \right]^{1/2}}$$

课本210页

查表

 $N_D = 5 \times 10^{14} cm^{-3}$

2)根据N_D可算出C_{FB}

3)根据C_{FB}可得到V_{FB}

由C-V曲线可知,18pF对应电压为-17V

- 4)根据B-T实验原理,求可动电荷密度,需要知道 ΔV_{FB}
 - 由C-V曲线可知 $|\Delta V_{FB}| = \frac{Q_m}{C_{or}} = 7V$
- 5) 可动电荷密度

$$Q_{m} = \left| \Delta V_{FB} \right| C_{ox} = \frac{7 \times 22 \times 10^{-12}}{1.6 \times 10^{-3}} = 9.6 \times 10^{-8} C / cm^{2} = 6.0 \times 10^{11} q / cm^{2}$$